

# DDR3 SO DIMM 插槽

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3

堆叠高度: 5.2 mm

模块方向: 直角

位数: 144

中心线 (间距) : .8 mm

## 产品特性

### 参考编号

TE 内部编号	CAT-D33037-SO1339
---------	-------------------

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 2, 双倍数据速率 (DDR) 3, 小型 (SO)

### 结构特性

行数	2
托架数	2
钥匙数	1
模块方向	直角
位数	144

### 电气特征

DRAM 电压 (V)	1.8, 3.3
-------------	----------

### 信号特征

SGRAM 电压 (V)	1.8, 3.3
--------------	----------

### 主体特性

模块钥匙类型	DRAM, SDRAM, SGRAM
弹射器位置	两端, 无
弹射器类型	锁定

插销材料	不锈钢
插销电镀材料	锡
连接器外形	低, 标准, 高

#### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	金, 锡, 镀金
端子基材	磷青铜, 铜合金
内存插槽类型	内存卡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度 (μm)	.25, .76
端子接合区域电镀材料厚度 (μin)	9.84, 30

#### 端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

#### 机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准类型	左偏移, 标准键控
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	压具柱体, 焊尾

#### 壳体特性

壳体颜色	土黄色, 黑色
外壳材料	高温塑料, 高温热塑塑料
中心线 (间距) (mm)	.8
中心线 (间距) (in)	.031

#### 尺寸

堆叠高度 (mm)	5.2, 5.6
堆叠高度 (in)	.205, .22
行间距 (mm)	5.4, 6.2
行间距 (in)	.21, .244

#### 使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

#### 操作/应用



电路应用

Signal

**行业标准**

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

**包装特性**

封装数量

12, 20, 200, 240, 270

封装方法

Box, Tray, 卷带包装

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 3)

SKT,SODIMM,144P,1.5/1.35V  
(DDR3),STD,T&RSKT,SODIMM,144P,1.8V  
(DDR2),STSKT,SODIMM,144P,1.5/1.35V  
(DDR3),STD,TY-SSKT,SODIMM,144P,SDRAM3.  
3V,STD,T&R

TE 产品编号	1-1735251-3	1-1735251-2	1735251-3	6-390376-1
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 3	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR) 3	小型 (SO)
堆叠高度	5.2 mm	5.2 mm	5.2 mm	5.2 mm
连接器外形	标准	标准	标准	低
行间距	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm	5.4 mm
端子接合区域电镀材料厚度	.25 $\mu\text{m}$	.25 $\mu\text{m}$	.25 $\mu\text{m}$	.76 $\mu\text{m}$
封装方法	卷带包装	卷带包装	Box, Tray	Box, Tray
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR3 SO DIMM,AMP- METRIMATE	DDR2 SO DIMM,AMP- METRIMATE	DDR3 SO DIMM,AMP- METRIMATE	AMP-METRIMATE

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 3)

SKT,SODIMM,144P,SDRAM3.  
3V,HIGHSKT,SODIMM,144P,SGRAM3.  
3V,HIGH,TY-SSKT,SODIMM,144P,SDRAM3.  
3V,HIGHSKT,SODIMM,144P,SDRAM3.  
3V,STD,TY-S

TE 产品编号	3-390112-1	390111-1	390112-1	390113-1
DRAM 类型	小型 (SO)	小型 (SO)	小型 (SO)	小型 (SO)
堆叠高度	5.6 mm	5.6 mm	5.6 mm	5.2 mm
连接器外形	高	高	高	标准
行间距	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm
端子接合区域电镀材料厚度	.25 $\mu\text{m}$	.25 $\mu\text{m}$	.25 $\mu\text{m}$	.25 $\mu\text{m}$
封装方法	Box	Tray	Tray	Tray
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP-METRIMATE	AMP-METRIMATE	AMP-METRIMATE	AMP-METRIMATE

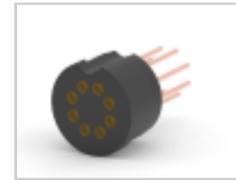
**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (3 of 3)

SKT,SODIMM,144P,SDRAM3.  
3V,STD,TY-HSKT,SODIMM,144P,SDRAM3.  
3V,STD,T&RSKT,SODIMM,144P,1.8V  
(DDR2),STSKT,SODIMM,144P,SDRAM3.  
3V,HIGH,T&R

TE 产品编号	3-390113-1	6-390113-1	1735251-2	6-390112-1
DRAM 类型	小型 (SO)	小型 (SO)	双倍数据速率 (DDR) 2	小型 (SO)
堆叠高度	5.2 mm	5.2 mm	5.2 mm	5.6 mm
连接器外形	标准	标准	标准	高
行间距	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm
端子接合区域电镀材料厚度	.25 μm	.25 μm	.25 μm	.25 μm
封装方法	Tray	卷带包装	Box, Tray	卷带包装
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP-METRIMATE	AMP-METRIMATE	DDR2 SO DIMM,AMP- METRIMATE	AMP-METRIMATE

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

